

Compression Molding System

Model CPM1300



**Compression molding system
for expanded super large size PLP**

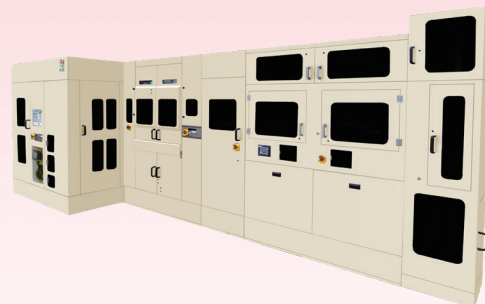
大判対応範囲拡大 超大判PLP成形に対応する コンプレッションモールド装置

製品情報



日本語

- 対応可能サイズを拡大し、最大715×715mmの超大判パネルの自動成形に対応
- 超大判サイズに最適な成形技術を採用
- 独自のキャビティダウン方式を採用し、高品質な成形を実現
- 顆粒樹脂の均一な散布により安定した成形が可能
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
モデル		—	CPM1300			
装置区分		—	Manual	Semi-Auto	Full-Auto	
ワークタイプ		—	パネル			
ワークサイズ		mm	□700 (Max.)			
樹脂		—	顆粒			
マシニングタイム		sec	—	—	Approximately 75	
外形寸法	プレス数	module	1	1	1	2
	幅	mm	2,550	5,075	6,258	8,008
	奥行き	mm	2,895	2,895	3,850	3,850
	高さ	mm	2,445	2,445	2,445	2,445
重量		ton	15.2	21.6	26.1	41.3
成形取り数		workpiece	1	1	1	2
マガジンスペース		—	—	—	FOUP Input/Output stage : 1 cassette each In/Out stage : Panel 1 by 1	
クランプ出力		kN/(tf)	49.0—2,940/5.0—300.0			
クランプ速度		mm/sec	47 (Max.)			
品種切替え方式		—	—	キット交換式		
リリースフィルム幅		mm	840 (Max.)			

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。

TOWA株式会社

【本社・工場】

〒601-8105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地

【海外販売拠点】

■中国

- ・ TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
- ・ Hechuang Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.

■台湾

- ・ TOWA Taiwan Co., Ltd.

■韓国

- ・ TOWA Korea Co., Ltd.

■シンガポール

- ・ TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

■マレーシア

- ・ TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

■タイ

- ・ TOWA THAI COMPANY LIMITED

■フィリピン

- ・ TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

■インド

- ・ TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

■ドイツ

- ・ TOWA Europe GmbH

■オランダ

- ・ TOWA Europe B.V.

■アメリカ

- ・ TOWA USA Corporation



TOWA (当社のハウスマーク)、はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

【お問い合わせ】

20260201-001-HQ